

泛半导体产业投资版图梳理报告



序言

INTRODUCTION

此份《泛半导体产业投资版图梳理报告》以我国半导体行业设计领域为研究核心，制造、封测及产业链上游的设备、材料等领域为延伸，对中国半导体行业投资环境及技术发展进行了初步研究。

通过对近两年业务与技术较为成熟的上市公司和一级市场获投资较为频繁企业的分析，报告对我国半导体行业发展的优势领域和短板进行了整理和解读。相比于其他机构的行研，我们更多地关注国家大基金以及投资机构的投资领域，总结了一些趋势的变化，并结合投资市场的数据产生了一些洞察。

另外，我们也对未来中国半导体行业的发展重点进行简单的分析，我们认为当下中国的半导体产业发展还存在诸多需要攻坚的领域，包括材料、工业软件、制造设备、存储芯片设计等。未来，我们也将继续关注半导体行业的发展动态与投资市场的风向，进行更深入的探讨，为后续在半导体领域的布局给出一些参考意见及相关数据支撑。

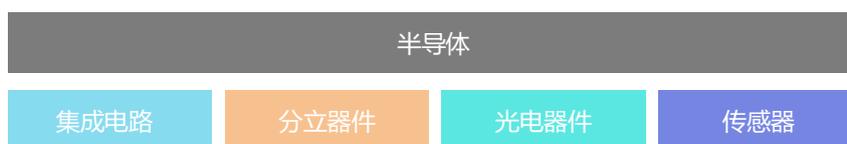
注：本报告以中国大陆为研究范围，未包含港澳台地区。

1、中国泛半导体产业发展概述

1.1 发展背景

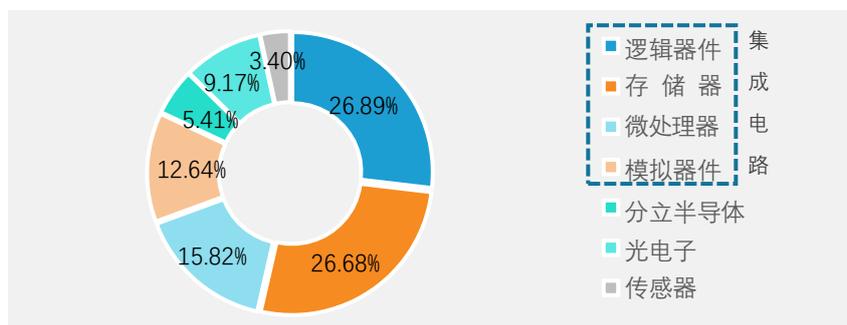
纵观过去半个世纪，半导体产业的迅猛发展为现代信息技术革命提供了基础。如今，半导体已经成为人们日常生活中的一部分，小至智能手机、智能手表，大到卫星、飞机，半导体已经无处不在。

根据应用场景的不同，半导体可以分为四个大类，分别是：集成电路、分立器件、光电器件及传感器。



集成电路是四类半导体器件中应用最为广泛的，据世界半导体贸易统计协会统计，2020年集成电路占全球半导体各类器件市场的82.03%，相比2019年占比80.8%又有一定提升。

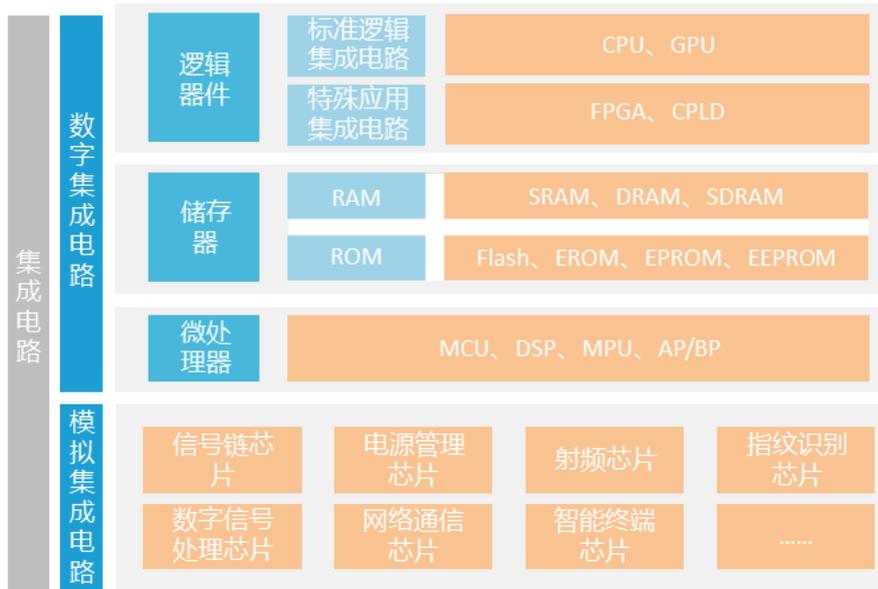
2020年半导体各类器件市场规模占比



数据来源：世界半导体贸易统计组织 (WSTS)

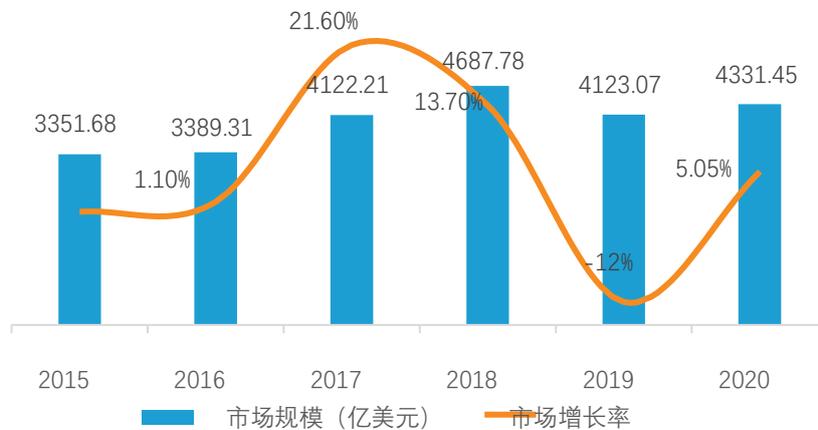
集成电路主要分为数字集成电路和模拟集成电路，其中数字集成电路主要包括逻辑器件、储存器和微处理器。逻辑器件是进行逻辑计算的集成电路；存储器是用来存储程序和各种数据信息的记忆部件；微处理器可完成取指令、执行指令，以及与外界存储器和逻辑部件交换信息等操作；模拟器件是模拟电路集成在一起用来处理模拟信号的芯片，如运算放大器、模拟乘法器、锁相环、电源管理芯片等。

集成电路分类



市场方面，据 WSTS 统计数据，自 2017 年起全球半导体销售规模已经连续四年超过 4000 亿美元。2019 年，由于存储芯片厂商产能扩张，市场供大于求；且模拟芯片需求也有所下降，导致世界半导体销售规模出现下滑。随后的 2020 年，疫情导致芯片出现短缺，全球销售规模又随价格波动和需求的增长而小幅上扬。

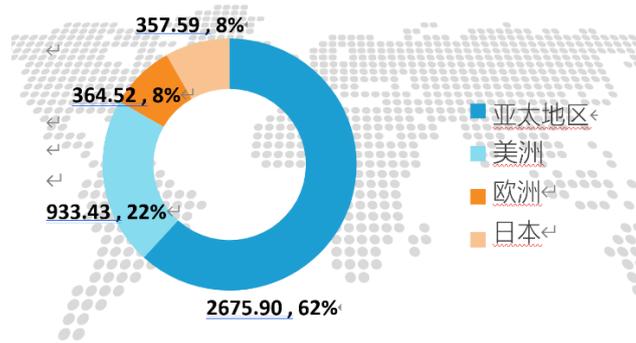
2015-2020 年全球半导体销售规模及增长率



数据来源：世界半导体贸易统计组织 (WSTS)

从区域分布来看，WSTS 统计结果显示，2020 年亚太地区(除日本)半导体市场规模为 2675.90 亿美元，占全球市场的 61.78%。

2020 年全球主要地区半导体市场规模 (亿美元)

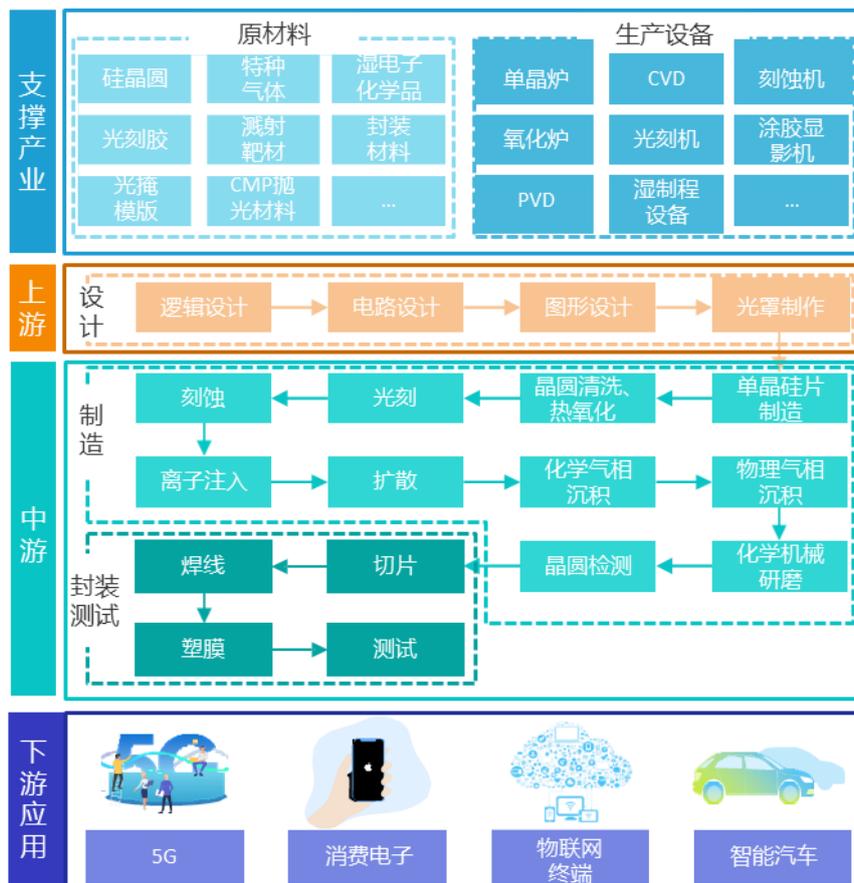


数据来源：世界半导体贸易统计组织 (WSTS)

1.2 行业态势

半导体产业链主要可以分为上中下游三大模块以及半导体行业的支撑产业，上游为芯片设计行业，中游是芯片的制造以及封装测试，下游是芯片的终端应用。半导体原材料以及制造设备是整个行业的支撑产业。

半导体产业链结构



其中，芯片设计较为独立，方向也比较多样；芯片制造和封测是主要技术领域，涉及工艺复杂。因此半导体行业主要存在三种商业模式：Fabless 模式、Foundry 模式和 IDM 模式。

模式	商业模式	代表厂商
----	------	------

Fabless	专注于芯片设计研发，制造、封装测试等环节外包给专业厂商	华为海思、英伟达
Foundry	晶圆代工	中芯国际、台积电
IDM	覆盖从芯片设计到制造、封装测试全流程	英特尔、三星

在整个芯片产业链中，我国除了上世纪七十年代起步的封测技术较为领先外，芯片设计、制造行业的整体水平还与领先国家有较大的差距。其中，在芯片设计领域，我国移动处理器设计水平与世界差距较小，其他细分领域均较为落后，缺乏高端芯片设计话语权；在制造环节中，先进制程工艺最为“卡脖子”，据中芯国际官方网站介绍，其 14 纳米 FinFET 技术于 2019 年第四季度进入量产，是中国大陆目前最先进水平，而 2021 年 4 月台积电 3 纳米工艺芯片已经进入试产，远远领先大陆水平。



资料来源：国元证券

在芯片设计领域，知识产权竞争十分激烈，中高端芯片几乎被海外厂商垄断，中国企业在全球半导体产业中长期处于中低端领域，逻辑、存储等高端芯片仍依赖进口。据国务院发布的相关数据，2019 年我国芯片自给率仅为 30%左右，提升高端芯片国产化率，实现高端芯片设计制造的国产化替代将是中国芯片产业下一阶段的重要奋斗目标。

国产芯片市场占有率

系统	设备	核心芯片	市场占有率
计算机系统	服务器	CPU	0%
	个人电脑	CPU/GPU	0%
	工业应用	CPU	20%
通用电子系统	可编程逻辑设备	FPGA/EPLD	0%
	数字信号处理设备	DSP	0%

通信设备	移动通信终端	Application Processor	18%
		Communication Processor	22%
		Embedded CPU/GPU	0%
		Embedded DSP	0%
	核心网络设备	NPU	15%
存储设备	半导体存储器	DRAM	0%
		Nand Flash	0%
		Nor Flash	5%
显示及视频系统	高清电视和智能电视	图像处理器	5%
		显示驱动	0%

资料来源：前瞻产业研究院，投研团队整理

备注：表格中数据均为近似值，“0%”代表市场占有率极低，与主流产品差距大

1.3 驱动因素

政策驱动力

为了提高中国自身芯片研发能力以及降低西方技术封锁对我国科技产业的影响。自2014年以来，我国依据半导体行业情况一方面出台政策对半导体从业公司进行税收减免，另一方面制定技术战略发展纲要指导半导体行业技术进步，多方面政策共同推动半导体行业进步。

中国半导体产业相关政策

相关政策	颁布时间	颁发部门	主要内容
《国家集成电路产业发展推进纲要》	2014.6	国务院	明确提出到2020年，IC产业与国际先进水平的差距逐步缩小，封装测试技术达到国际领先水平，关键装备和材料进入国际采购体系，基本建成技术先进、安全可靠的集成电路产业体系，实现跨越式发展。
《中国制造2025》	2015.5	国务院	“中国制造2025”战略的实施带动集成电路产业的跨越发展，以集成电路产业核心能力的提升推动“中国制造2025”战略目标的实现。
《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	2016.3	国务院	大力推进先进半导体等新兴前沿领域创新和产业化，形成一批新增长点。推广半导体照明等成熟适用技术。

《国家信息化发展战略纲要》	2016.7	中共中央办公厅、国务院办公厅	制定国家信息领域核心技术设备发展 战略纲要，以体系化思维弥补单点弱 势，打造国际先进、安全可控的核心 技术体系，带动集成电路、基础软件、核心元器件等薄弱环节实现根本性突 破。
《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》	2017.1	国家发改委	根据战略性新兴产业发展新变化，对《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(以下简称《目录》)2013版作了修订完善，依据《规划》明确的5大领域8个产业，包括半导体材料和集成电路等。
《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》	2019.5	财政部、税务总局	依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2018年12月31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。
《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》	2020.8	国务院	凡在中国境内设立的集成电路企业和软件企业，不分所有制性质，均可按规定享受相关政策。鼓励和倡导集成电路产业和软件产业全球合作，积极为各类市场主体在华投资兴业营造市场化、法治化、国际化的营商环境。

下游市场驱动力

除了国家政策和外部贸易环境的影响，自动驾驶、人脸识别、通信技术和云计算等新兴产业的快速发展促使半导体行业本身加速进步，以适应更多元化的应用场景和更庞大的算力需求。

从终端应用需求来看，通信行业（手机）、计算机是半导体行业的主要 需求侧。据美国半导体行业协会数据，2019 年全球半导体应用中通信行 业和计算机行业应用占比分别为 33%和 28.5%。

2019 年全球半导体终端应用市场结构



数据来源：SIA

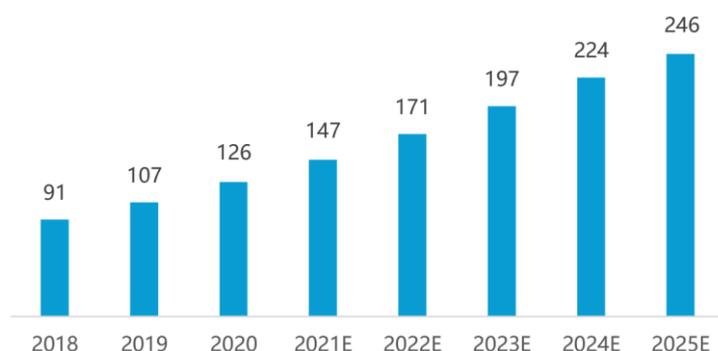
物联网产业迅猛发展是芯片需求增长的一大推动力，物联网产业感知、传输、平台、应用四层架构中的每一层级，都需要各类芯片的参与。其中物联网终端层、边缘计算层和应用层对芯片的需求更加多元化，数量也相对较大。

物联网产业不同层级对芯片需求梳理



据 GSMA 统计数据显示，2020 年，全球物联网设备连接数量高达 126 亿个，GSMA 预测到 2025 年这一数字将达到 246 亿。近年来全球物联网设备数量高速增长，五年后全球物联网设备数量近乎翻倍。

2018-2025 全球物联网设备联网数量及预测（亿个）



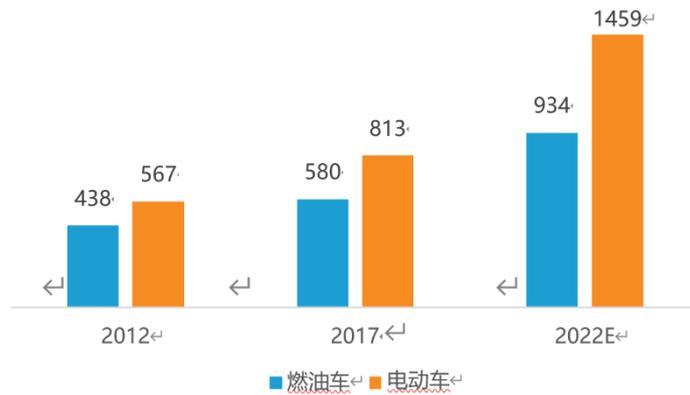
数据来源：GSMA

物联网基本可以分为面向公用事业单位、面向企业（to B）和面向消费者（to C）三个领域。其中智慧汽车、智慧家庭、智慧工厂等领域在近年来受到广泛关注，带动相关芯片的需求增长。

公用事业	智慧政务、智慧医疗、智慧社区、智慧安防.....
To B	智慧工厂、智慧能源、智慧物流、智慧农业.....
To C	智慧家庭、智慧汽车、可穿戴设备.....

以智慧汽车为例，目前汽车集成了更多提升驾乘体验的功能，如驾驶辅助、车联网、智慧座舱等，已经远远超出了作为代步和货运工具的角色。而这些智能化的功能都由复杂的机电系统完成，这些系统通常是由机械设备、传感器和多种芯片共同组成的。智慧汽车的发展也使得汽车对芯片的需求不断提升。据中汽协预测，到 2022 年，中国品牌电动汽车平均芯片数量将高达 1459 颗。

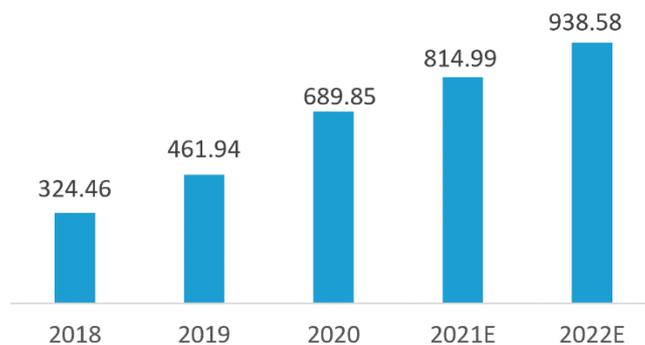
中国品牌汽车平均芯片数量（颗/辆）



数据来源：中国汽车工业协会

智能可穿戴设备也是物联网的一大应用领域。近年来，智能可穿戴设备市场不断扩大，据 Gartner 统计，2019 年全球用户在可穿戴设备的支出为 461.94 亿美元，2020 年达到 689.85 亿美元，增幅达到 49.3%。随着下游市场快速扩大，上游芯片需求也将水涨船高。

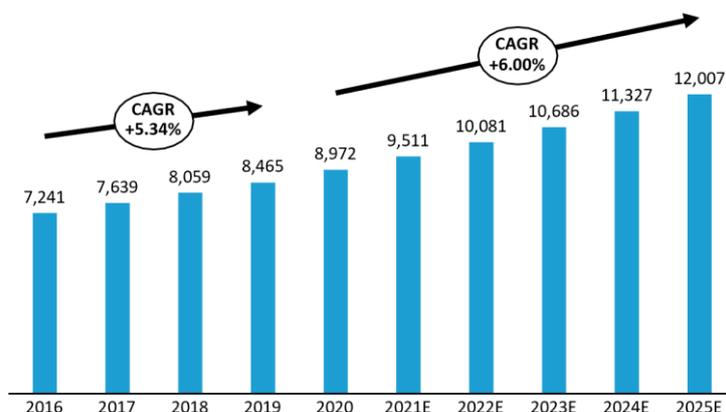
全球可穿戴设备支出（亿美元）



数据来源：Gartner

在面向消费者的设备之外，智慧工厂的建设也如火如荼。与面向消费者的设备不同的是，智慧工厂、工业互联网应用的芯片多为工作温度范围更广、设计使用寿命更长的芯片，其在制造与封装工艺上的要求也更高。在芯片种类方面，工业应用中对电源管理芯片、信号链芯片等模拟芯片的需求更大，对微控制器、逻辑芯片等也有一定需求。

全球工业互联网市场规模（亿美元）及复合增长率



数据来源：前瞻研究院，赛迪智库

数据显示，2016 至 2019 年，全球工业互联网市场规模复合增长率超过 5%，总量已经

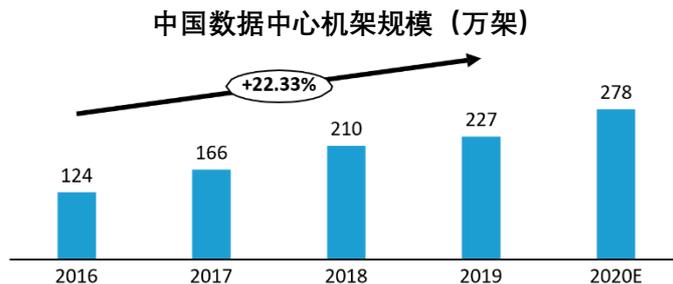
逼近 8500 亿美元，市场体量庞大。机构预测在 2020 年至 2025 年，这一市场将继续保持 6%左右的复合增长率，在 2025 年市场规模将超过 1.2 万亿美元。

智慧安防也是备受关注的行业，行业又可以划分为城市安全、企业及机构安防、家庭安防等不同的细分领域，每一领域中都有。智慧安防设备包括监控设备、人脸识别摄像头、中央计算平台、智能报警器等，这些设备都需要芯片实现一定的功能。据中安网数据，2020 年全国安防行业增长率为 3%，总产值达到 8510 亿元。2019 年，智慧安防在整个安防市场的渗透率约为 5.5%，可以预见这一比例在未来短期内将会极速上升。据估算，2026 年前后我国智慧安防市场规模将达到 2500 亿元人民币。这一市场快速增长的同时，会拉动对显示控制芯片、各类通信芯片、微控制器、用于 AI 计算的逻辑芯片等不同芯片种类的需求。

除了设备外，云计算等后端算力同样对芯片有巨大需求。云计算是将计算能力以服务的形式提供给用户。数据中心则是云计算服务的基础设施，其主机房包含了交换机、服务器和其它与之配套的设备（例如通信和存储系统）。

由于数据中心需要对大量原始数据进行运算处理，对于芯片等基础硬件的计算能力、存储能力等都有较高要求。

据赛迪顾问数据，截至 2019 年，中国数据中心数量约为 7.4 万个，约占全球数据中心总量的 23%，机架数量由 2016 年的 124 万架上升至 2019 年的 227 万架，年复合增长率超 20%。



数据来源：赛迪智库

在数据传输端，5G 技术的应用也推动芯片需求的增长。除了在消费端的应用，如手机里的 5G 基带芯片，大量的芯片需求来自于 5G 基站的建设。不同于 4G 基站，5G 信号频段特性决定了将信号覆盖同样的面积，其基站数量将是 4G 基站的 2 倍及以上。据工信部数据显示，截至 2021 年 3 月底中国 5G 基站数量达 81.9 万座，2021 年预计新建基站 80 万座。同时，高盛预测，中国 5G 基站将在未来五年循序渐进式增长。



数据来源：工信部，高盛

2、半导体产业投融资概况

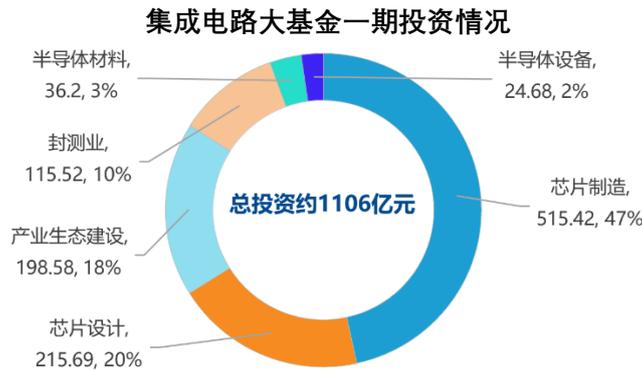
2.1 资本市场动态分析

国家牵头加码半导体产业投资

为了从全方位鼓励半导体行业发展，国家在出台一系列优惠政策之外，还牵头成立产业基金，直接参与到半导体产业投资中去。2014年，国家颁布《集成电路产业发展推进纲要》，提出设立国家集成电路产业基金（简称“大基金”），将半导体产业新技术研发提升至国家战略高度。

基金首批计划募集规模为1200亿元，截至2017年6月募资规模已达到1387亿元，超募15.6%。此外，大基金的引领作用明显，共撬动5145亿元的地方和社会资本参与集成电路及相关产业投资，总计约6500亿元资金进入集成电路行业，为行业进步提供了充足的资金支持。

从资金流向上看，主要集中在芯片制造和芯片设计领域，其中，芯片制造515.4亿元；芯片设计215.7亿元。国家集成电路产业基金一期近半流向了研发资金需求大、工艺复杂、技术攻坚困难的芯片制造领域，投资方向集中于存储器和先进工艺生产线。



数据来源：公开数据搜集整理，数据截至2019年

地方及社会资本踊跃进场

在大基金的带动下，相关的新增社会融资（含股权融资、企业债券、银行、信托及其他金融机构贷款）达到约5000亿元人民币，各地方政府和协会等机构也纷纷成立子基金。据大基金管理机构华芯投资表示，按照基金实际出资结构，中央财政资金撬动各类出资放大比例高达约1:19。

大基金一期带动部分地市集成电路产业投资基金规模（亿元）



数据来源：中泰证券

据全球半导体观察报道，大基金负责人在集成电路零部件峰会上透露，国家集成电路产业基金二期已基本募集完毕，向半导体相关企业投资在即。据国家开发银行董事长赵欢在 2021 年 3 月 2 日的新闻发布会上透露，大基金一期的投资已经圆满完成，大基金二期募集了 2000 亿资金，目前已经全面进入了投资阶段。可以预见，在 2021 至 2023 年将会是大基金二期对企业投资的活跃年份，又将会有一批优秀的半导体行业企业获得大体量的资金支持。

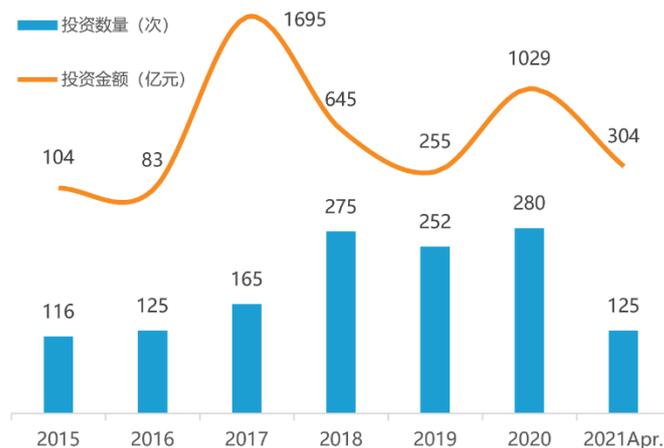
另外据公开资料显示，国家集成电路产业投资基金二期于 2019 年 10 月 22 日成立，注册资本高达 2041.5 亿元，规模比一期又有进一步的扩大。同时，大基金二期的投资重点将向芯片设备和材料领域倾斜，会对塑造自主知识产权比重高的集成电路产业链、发展集成电路相关支撑行业起到良好的促进作用。截至 2021 年 4 月 20 日，大基金二期对外投资共 9 家企业，除长川智能专注于设备制造外，另外八家企业仍然集中于 IDM 模式和芯片制造行业。

2.2 市场投融资事件整理

随着国家政策的推动和地方政府关注度的提升，半导体产业在近几年迎来了爆发期。据企查查数据显示，截至 2020 年 10 月，我国共有芯片企业 4.9 万家，其中 2020 年新增注册企业达到 1.2 万家，增速超过 30%。

企业数量激增的同时，私募股权市场的热度也在不断飙升。根据 IT 桔子数据显示，在 2010 年，我国半导体行业投资频次为 27 次，投资总金额仅为 9.8 亿元，平均投资金额仅为 3600 余万元人民币。2016 年之前，半导体行业的投资行为呈现缓慢增长态势，每年的投资行为数量有了一定的提升，达到百余次；但总投资金额围绕一百亿元人民币上下波动，进入行业的资金没有明显的增加。

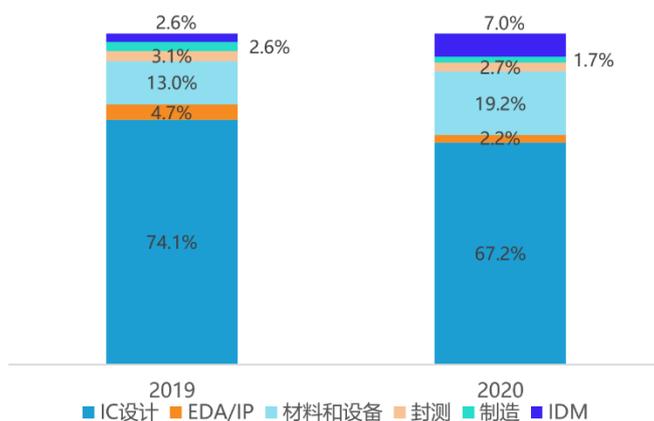
2015-2021 年半导体行业投资数量及金额走势



数据来源：IT 桔子

从投资细分领域来看，私募的投资重点主要是芯片设计和芯片产业的支撑产业如材料与设备制造。近两年芯片设计行业发生的投资数占比均超过总数的三分之二，是投资的绝对重点，反映了目前国内资本市场对资金投入相对较小、设备和技术受限程度较低的芯片设计行业更加青睐。

2019-2020 年半导体细分行业投资数量占比



数据来源：云岫资本

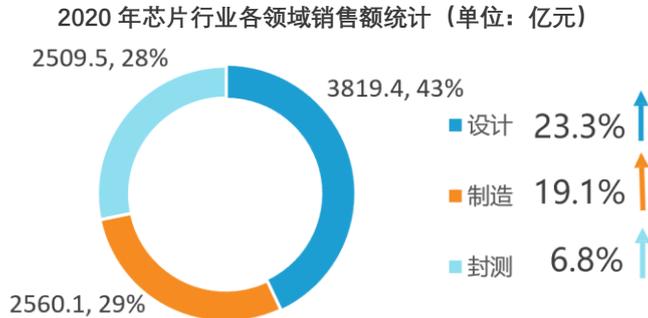
在政策的引导下，2020 年我国半导体发展由重点投资设计、制造领域，逐步向全产业链发展转变。因此在 2020 年投向材料和设备的资金占比也有了一定的增加。

据 C114 通信网消息，2020 年，芯片领域发生投融资事件 458 起，拿到融资的企业共计 392 家，总融资金额高达 1097.69 亿元。其中最高融资金额被中芯国际拿下，合计 198.5 亿元，由国家大基金一期、国家大基金二期、上海集成电路和国家集成电路共同注资，皆为国资背景。同为芯片制造领域的中芯南方斩获 22.5 亿美元投资。这反映出在 2020 年，我国芯片行业投资呈现芯片设计企业获投次数多，资金量小；芯片制造企业获投资资金量大，企业数量少的现状。这一现状既表现出资本对我国芯片制造业的信心，也反映出其耗资大，投资存在风险的特征。

3、中国半导体行业未来展望

3.1 中国半导体行业发展趋势

根据中国半导体行业协会统计，2020 年我国集成电路产业销售额为 8848 亿元人民币，同比增长 17%。其中，设计业销售额为 3778.4 亿元，同比增长 23.3%；制造业销售额为 2560.1 亿元，同比增长 19.1%；封装测试业销售额 2509.5 亿元，同比增长 6.8%。



数据来源：中国半导体协会

根据三个领域增长的趋势可以看出，我国制造、设计行业在政策鼓励和资金支持的双重作用下已经出现两位数的增长，基于自动驾驶汽车、工业互联网、云计算在未来几年的增长前景判断，我国半导体产业销售规模在未来几年将保持两位数的高速增长。

在“十四五”开年之际，各地方政府对所管辖区域芯片行业的长处与短板应有清晰的梳理。在新一轮的项目招商和落地过程中，优先着力于充实优势领域的产业链，补齐产业链缺少的环节和板块，向上游或下游产业链延伸发展，发挥地方产业特色，将过去积累的芯片产业资源聚拢、活化，形成规模化、链条化的产业聚集区和产业园。芯片行业是资金密集型与技术密集型产业，对资金、人才、产业成熟度的要求都比较高，地方政府在招商引资的过程中，对于新的芯片门类、新的产业方向要谨慎落地，避免企业水土不服，造成资源和时间的浪费。

在国家优惠政策、产业基金充沛和庞大内需的推动下，可以预见在不久的将来，我国芯片行业将有更多的领域跻身世界前列，立于世界之巅。

3.2 中国半导体行业面临的挑战及重点投资方向

虽然我国芯片行业在市场和政策的双重促进下正保持着高速发展，但我们也应该清楚地认识到我们存在的短板和不足。综合来看，我国芯片行业已经面对或未来将会面临的挑战将会主要出现在生产设备难以突破、设计工具自主水平低、材料发展水平有待提升、行业人才存在缺口等方面。

生产设备难以突破

先进的芯片制造工艺高度依赖尖端的芯片制造设备，我国在最重要的光刻机上与世界领先的 EUV、DUV 机器都有不小的差距，在多年的探索中进步较为缓慢。除了光刻机之外，我国企业生产的用于薄膜沉积和离子注入的设备与世界水平差距较大。

芯片制造主要环节及各环节设备国内主要提供商



目前世界顶尖芯片制造商——中国台湾的台积电已经在测试 3nm 工艺制程，5nm 工艺制程已经实现商用。生产设备国产化水平无法满足高端芯片需要的现状下，荷兰 ASML 公司拒售最先进的 EUV 光刻机严重限制了我国高端芯片制造的发展。在美国对华科技企业发起一系列制裁后，我国顶尖的芯片设计公司海思便无法通过台积电进行高端芯片的代工，国内无法满足生产需求的现状下，相关业务发展不得不陷入停滞。目前，芯片制造关键设备基本都被日本、美国的设备制造商把持，一旦国际政治环境出现恶化，我国芯片制造的其他环节也会直接陷入产能无法继续提升的窘境。

设计工具自主水平低

芯片设计主要需要使用 EDA 仿真软件等设计工具，据雷锋网援引赛迪智库分析师的发言，2019 年在 EDA 市场国产化替代率仅约 10%，且份额基本被产品较为全面的华大九天占据。世界顶尖的三家 EDA 设计公司 Synopsys、Cadence 和 Mentor 都是美国公司，我国的华大九天、芯远景、芯禾科技、广利微电子等企业也能够提供部分环节的 EDA 软件，但在技术成熟度和完整性上与顶尖企业还存在差距，在高端芯片设计中，中国企业还没有非常好的本土化软件可以替代。

材料发展水平有待提升

在芯片材料方面，我国的大尺寸硅片、光刻胶、掩膜板制造技术与目前的芯片设计水平还存在差距，许多门类的材料不能满足国内企业生产制造需求，需要依赖进口。在设计软件、芯片制造设备、芯片制造核心材料，部分封测设备上都存在短板，导致我国芯片行业发展受到国外限制的领域较多，容易在政治环境较差的时候陷入发展停滞的局面。

行业人才存在缺口

我国半导体集成电路长期以二级学科地位发展，直到 2020 年 7 月底才被确定设立为一级学科独立发展。学科等级也影响了高等院校和科研机构对集成电路的独立支持，独立的高校和学院近几年才逐渐设立，如南京市于 2020 年 11 月设立专门的南京集成电路大学，清华大学于 2021 年 4 月 22 日才成立独立的集成电路学院，这对行业人才的专门化培养有很大的影响。据《中国集成电路产业人才白皮书（2019-2020 年版）》数据显示，截至 2019 年年底，我国直接从事集成电路产业的人员规模在约为 51.19 万人，同比增长 11.04%。相比 2017 年的 40 万人，2 年增长了 11.19 万人。

后记

2020 年是中国半导体产业异常坎坷的一年，国内半导体行业的企业在疫情和外部环境的影响下艰难发展。新冠疫情的全球“大流行”导致许多企业停工，半导体行业受上游供应不足和下游需求下降的双重影响，增长速度放缓；中美贸易战过程中，中国半导体企业接二连三受到制裁，给中国半导体行业带来沉重打击。疫情和外部政治因素使我国发展半导体国产化替代的需求更加迫切，目标也更加坚定。

2020 年 11 月，中共中央发布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，明确提出要瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。2020 年 7 月，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，也提到中国芯片自给率要在 2025 年达到 70%。在下游企业需求增长和国家政策的双重推动下，中国半导体产业在逆境中也迎来了重大机遇。

2021 年是“十四五”规划的开局之年，我国的半导体企业在当下应该认识和把握发展规律，准确识变、科学应变、主动求变，在危机中育先机、于变局中开新局，抓住机遇，打好开局之战。

我们对中国半导体产业崛起深信不疑，但崛起之路并非康庄大道。作为国家发展重要战略之一，半导体行业已经受到资本市场和各级政府的关注，国务院、各部委和地方政府相继出台政策对产业进行扶持；一级市场投资火热，二级市场对半导体企业认可度高，大量资金涌入半导体行业。在优惠政策和巨额资金带来行业快速发展的同时，也催生出资本泡沫和产业虚假繁荣等隐忧。在当下，各级政府、投资机构和行业内企业需要深思的是：未来一段时间，如何脚踏实地，确保我国半导体产业良性发展、实现长期繁荣。